

THERMO MODULE DATA

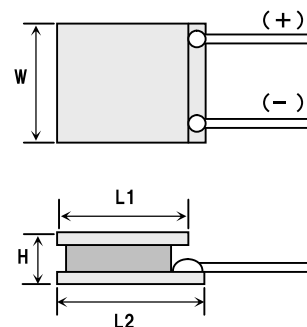
型式 KSM-06007C

[RoHS 2002/95/EC Compliant]



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27°C	64	6.0	0.8	3.0
50°C	73	6.0	0.9	3.4

	W	L1	L2	H
寸法(mm)	10.3	10.3	12.2	3.80
公差(mm)	±0.5	±0.5	±0.5	±0.15
上下メタライズ	無し			
セラミック材質	アルミナ			
組立半田	SnAgCu (217°C)			

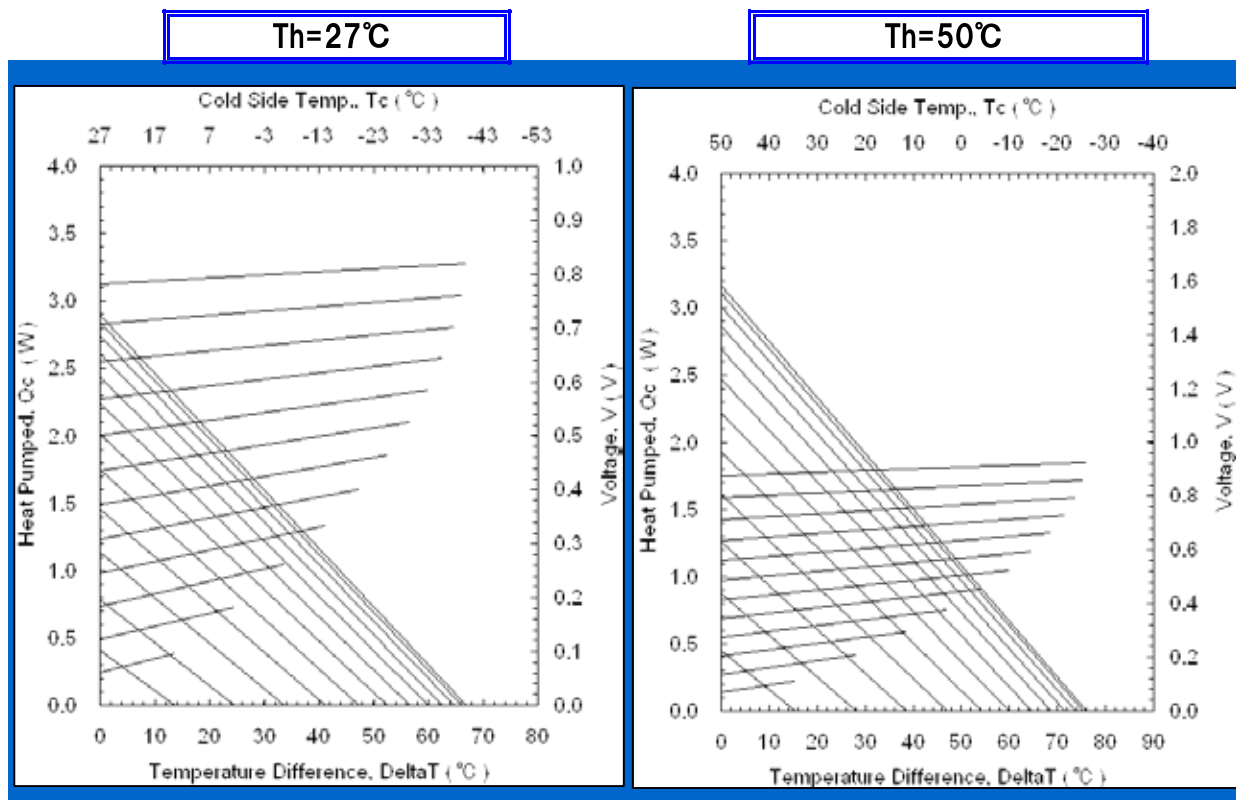


オプション

厚み公差 平均厚み : ±0.025mm

結露防止 エポキシシール

性能特性図



雰囲気 窒素

電流値 $I = 0.5 - 6.0 A$ (Step = 0.50A)

株式会社KELK

www.kelk.co.jp

■本社・工場

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

TEL 0463-22-8724

FAX 0463-22-3692

■素子事業部 技術営業Gr

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1

TEL 0463-23-3697

FAX 0463-24-6749

E-mail : sales@kelktech.komatsu.co.jp